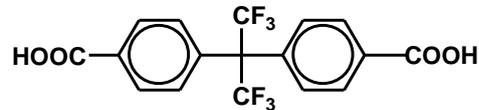


2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane(略号 ; 6F-diacid)

2,2-ビス (4-カルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン



Purity	97%
CAS Number	1171-47-7
Molecular Formula	C17H10F6O4
Molecular Weight	392.25

(1)低誘電率、低吸湿性の高耐熱材料として OH 基を持つポリベンゾオキサゾール(PBO)に着目し、その各種共重合体の誘電率、T_g を検討。OH 基の含有率を上げることにより T_g は画期的に上昇する傾向を認めた。また OH 基含有モノマー量を調整することにより誘電率を PTFE、FEP 並みに下げることが達成。吸湿度 0.2%、熱膨張係数 53ppm(-127°C~323°C)。

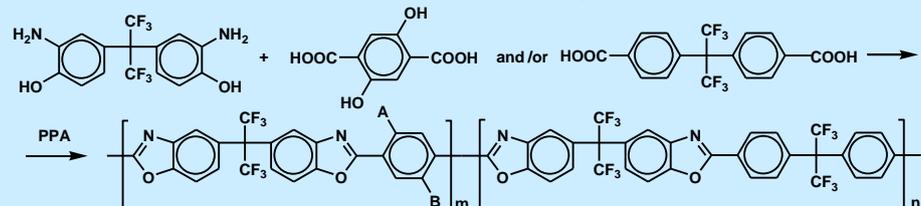


表-1 PBO の構造・組成と誘電率

Ex.No.	A	B	m	n	T _g (°C)	誘電率 (1MHz)
1	H	H	0	10	325	2.32
3	OH	H	10	0	426	2.35
7	OH	OH	10	0	415	2.88
2	H	H	5	5	346	2.40
5	OH	H	7	3	373	2.09
6	OH	H	5	5	363	2.15

Note: Ex.6 T_d = 532°C. 吸湿率 = 0.2%, 熱膨張率 = 53ppm

J. Polym. Sci.: Part A: Polym. Chem., 2000, Vol.38, p1991-2003

Properties:

Appearance	Solid
Melting point, °C	272-274
Boiling point, °C	-

Capacity:

-

Packing:

-

UN, PG:

-